

ABSTRACT

The present invention provides a moisture-absorbent formed body comprising 1) an amine compound and/or a thermally conductive material, 2) a hygroscopic agent, and 3) a resin component, for removing moisture from within the sealed atmosphere of an organic electroluminescent device, and thereby suppressing the occurrence of dark spots.

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19)世界知的所有権機関  
国際事務局



(43)国際公開日  
2004年1月15日 (15.01.2004)

PCT

(10)国際公開番号  
WO 2004/006628 A1

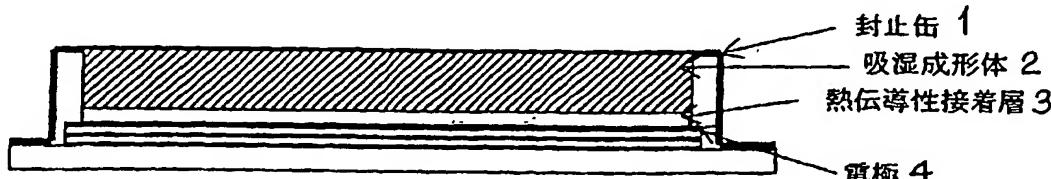
- (51)国際特許分類<sup>7</sup>: H05B 33/04
- (21)国際出願番号: PCT/JP2003/008574
- (22)国際出願日: 2003年7月7日 (07.07.2003)
- (25)国際出願の言語: 日本語
- (26)国際公開の言語: 日本語
- (30)優先権データ:  
特願2002-198922 2002年7月8日 (08.07.2002) JP  
特願2002-214029 2002年7月23日 (23.07.2002) JP
- (71)出願人(米国を除く全ての指定国について): ダイニック株式会社 (DYNAMIC CORPORATION) [JP/JP]; 〒615-0812 京都府 京都市 右京区西京極大門町26番地 Kyoto (JP).
- (72)発明者; および
- (75)発明者/出願人(米国についてのみ): 内堀 輝男 (UCHIBORI,Teruo) [JP/JP]; 〒522-0341 滋賀県 犬上郡 多賀町大字多賀270番地 ダイニック株式会社 滋賀工場内 Shiga (JP). 大山 兼人 (OHYAMA,Kaneto) [JP/JP]; 〒522-0341 滋賀県 犬上郡 多賀町大字多賀270番地 ダイニック株式会社 滋賀工場内 Shiga (JP). 宮澤 健太郎 (MIYAZAWA,Kentaro) [JP/JP]; 〒522-0341 滋賀県 犬上郡 多賀町大字多賀270番地 ダイニック株式会社 滋賀工場内 Shiga (JP). 川口 洋平 (KAWAGUCHI,Yohei) [JP/JP]; 〒522-0341 滋賀県 犬上郡 多賀町大字多賀270番地 ダイニック株式会社 滋賀工場内 Shiga (JP).
- (74)代理人: 三枝 英二, 外 (SAEGUSA,Eiji et al.); 〒541-0045 大阪府 大阪市 中央区道修町1-7-1 北浜TNKビル Osaka (JP).
- (81)指定国(国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84)指定国(広域): ARIPO特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:  
— 国際調査報告書

(続葉有)

(54) Title: HYGROSCOPIC MOLDING

(54)発明の名称: 吸湿性成形体



- 1...SHIELD CAN
- 2...HYGROSCOPIC MOLDING
- 3...HEAT TRANSFER ADHESIVE LAYER
- 4...ELECTRODE

(57) Abstract: A hygroscopic molding for removing moisture from a sealed atmosphere of organic EL element and thus for inhibiting the occurrence of dark spots, comprising at least one of an amine compound and a heat transfer material (1), a hygroscopic agent (2) and a resin component (3).

(57)要約: 有機EL素子の密閉雰囲気内の水分を除去し、ひいてはダークスポットの発生を抑制するため、1)アミン系化合物及び熱伝導性材料の少なくとも1種、2)吸湿剤及び3)樹脂成分を含有する吸湿性成形体を提供する。

WO 2004/006628 A1

Rec'd 2004 03 JAN 2005

2004/006628 A1



2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。